

JA 0006468

JAN 1977

117

BEST AVAILABLE COPY

<p>LE3 M20 P15 R45 (M26) SUMMO 04.07.75 METAL IND KK *JS 2006-468</p>	<p>L13-D3F1 M(23-A1).</p>
<p>A-002884 (19-01-77) 823k-35/26 C22c-13 H011-23/14 cut by diamond blade, for semiconductor use - contains tin, copper and/or antimony</p>	<p>98</p>
<p>alloy consists of 80 to 90 wt. % of Sn, 5 to 35 wt 3 to 13 wt. % of Cu and/or Sb. It is suitable semiconductor pellet bonding. The solder layer good absorber of thermal stress in a semicon- ductor.</p>	<p>J52006468</p>

⊕

90.60~90.8、Ag 5~3.5% なることを要
求とするものである。

[illegible]

本誌のあり方は、編輯者の態度による。編輯者の態度は、この一冊の新聞であるので、それよりやや高き態度するの付けを要することゝ出来、パワー・スタンダードの適用における約二〇〇に達する態勢に於いても其限を越えず、この後期の新聞による半世紀の歴史的な変化の起るをそれもない。

またこのうち材は、設備におけるマイクロボツ
カー設備が、種別による集積時間／秒が規定
して、その80%以上であり、通常の0.60-0.80秒以内

[illegible]

实验结果：

[illegible]

この面を、スライディング・ドア・システムに換へ、
のラックに収納した。より高度な場所では、開
時は昇降機を動かす必要があり、閉時の場合は
壁面を押し、スライディング・ドアの表面を
うたてて、の壁に上り、スライディング・ドア
欠けたり破れたりしたものを修繕してあげた。

事例例

4 前記以外の発明者

住 所	東京都目黒区平山 5-9-22
氏 名	長 野 健
住 所	東京都目黒区河辺 4丁目 5-15
氏 名	森 野 明 夫

、図 2 の Cu-Be-As 系合金の代りに、
 4. Be 20%、As 25% の合金 (ビツカー・スケール 14-15HV) 及び Cu 45%、Be 34%、As 7.5%、
 Ag 1.5% の合金 (ビツカー・スケール 10-11HV) を
 用いて、図 2 の合金に比較して、強度、延性を
 向上させた。

本発明は、図 2 の合金を使用すれば、延性を向上
 させ、強度を向上させることができる。また、
 合金の成分を調整して、強度を向上させること
 ができる。また、合金の成分を調整して、延性を
 向上させることができる。

代理人 東京工業大学 工学部

BEST AVAILABLE COPY